

CEI 60749-8
(Première édition – 2002)

**DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS –
MÉTHODES D'ESSAIS MÉCANIQUES
ET CLIMATIQUES –**

Partie 8: Etanchéité

IEC 60749-8
(First edition – 2002)

**SEMICONDUCTOR DEVICES –
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS –**

Part 8: Sealing

CORRIGENDUM 2

Page 6

Au lieu de:

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2012.

lire:

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.

Page 7

Instead of:

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2012.

read:

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2007.

Document Preview

[IEC 60749-8:2002/COR2:2003](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/b5aca36c-1de2-4277-913b-c35047587297/iec-60749-8-2002-cor2-2003)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/b5aca36c-1de2-4277-913b-c35047587297/iec-60749-8-2002-cor2-2003>